

Mini-Din Verbinder, Buchsen/Stecker, ohne/mit Gehäuse - für Kabelkonfektionen Mini-Din Jacks, Jacks/Plugs - With/Without Housings - For Cable Assemblies

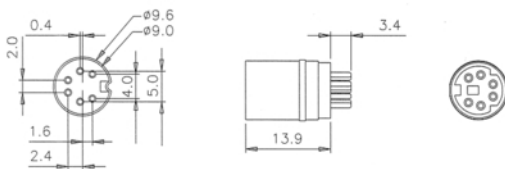
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 15mΩ
Contact Resistance	< 15mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{DC}
Test Voltage	500V _{DC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +105°C
Temperature Range	-55°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering

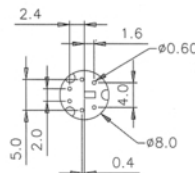


© W+P PRODUCTS

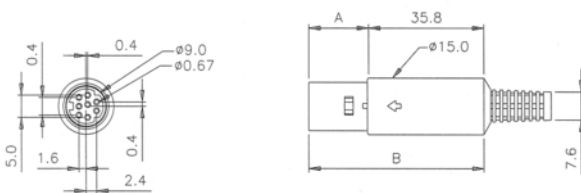
Passende Gegenstecker Serie:
Mate with Connector Series:
645 (Female)



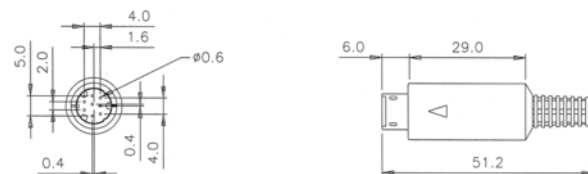
Molded Type (Female)



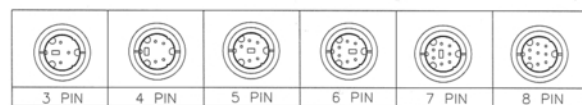
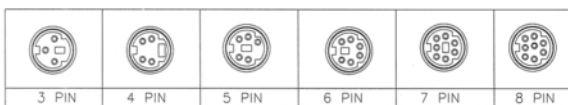
Molded Type (Male)



Assembly Type (Female)



Assembly Type (Male)



Series

646

Contacts*

05

03/04/05/06/07/08

Type*

1

1 Stecker ohne Gehäuse
Male mold type
2 Stecker mit Gehäuse
Male assembly type
3 Buchse ohne Gehäuse
Female mold type
4 Buchse mit Gehäuse
Female assembly type

Plating

50

50 Verzinnt
Tin plated

Andere Veredelungen auf Anfrage.
More plating options on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

